

はんだのクラック発生を抑制し、高放熱をサポート

Controls solder cracking and supports high heat dissipation

ECO SOLDER® PREFORM

Niボール応用ソルダプリフォーム

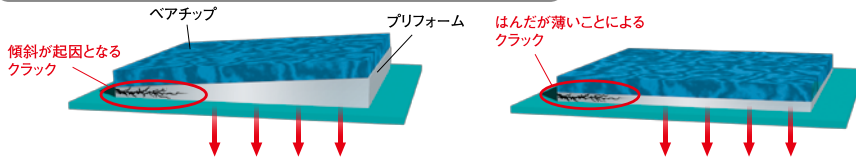
特長

- プリフォームによる一定量のはんだ供給で、一定のはんだ厚みを保証。
- Niボールをスペーサーに、傾斜なくベアチップを実装。
- はんだ厚や傾斜に起因するはんだクラックを抑制でき、放熱性の高い実装が可能。
- 良好な放熱性で、ベアチップの長期的な品質を保証。

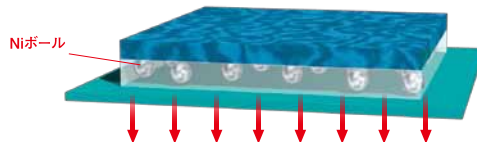
製品仕様

高い放熱効果

クラックの空気層が、熱伝導性を阻害し放熱効果を低下させる

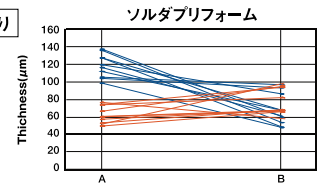


良好な放熱性

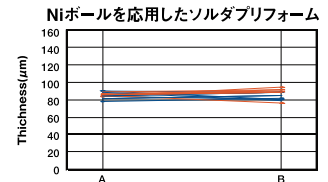


接続部2箇所の膜厚比較

傾斜あり



水平



ECO SOLDER® PASTE

Cuボール含有ソルダペースト

特長

- スペーサー入りペーストで、一定のはんだ厚さを確保。
- スペーサー入りペーストで、傾斜の無い実装が可能。
- はんだ厚や傾斜に起因するはんだクラックを抑制でき、放熱性の高い実装が可能。

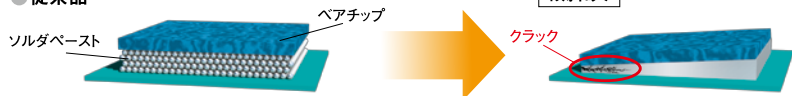
※はんだの組成についてはお問い合わせ下さい

製品仕様

スペーサー用途模式図
ベアチップ版 (従来品との比較)

リフロー時はんだのみ溶融しCuボールは残ります。部品を水平に保ち、一定のクリアランスを確保します。結果、放熱性の高い実装を可能にします。

●従来品



●Cuボール含有ソルダペースト



ペースト印刷搭載時

実装後